

先孔工法対応 ポリイミドフィルムへのニッケルシード層形成プロセス

トップSAPINAプロセス

Applicable to Polyimide Film with Hole Nickel Seed Layer Forming Process on Polyimide Film

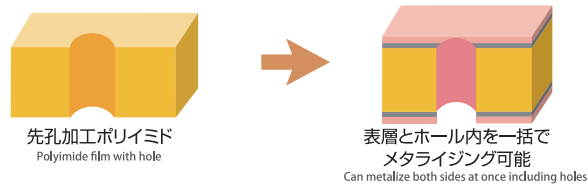
TOP SAPINA PROCESS

- 全工程湿式プロセスであり、Roll to Roll処理により両面を一括でメタライズ可能
- 金属濃度の低下による低コスト化を実現
- パラジウム吸着量の制御による優れたパターン性
- 先孔工法に対応

- All steps : Wet process
- Metallizing both sides at once by Roll to Roll treatment
- Low metal concentration, effective in cost reduction
- Great fine patterning performance by controlling palladium adsorption amount
- Applicable to polyimide film with hole

処理工程

Process



低いパラジウム濃度

Low palladium concentration

浴中パラジウム濃度と吸着量の比較

Comparison of palladium concentration and adsorption amount

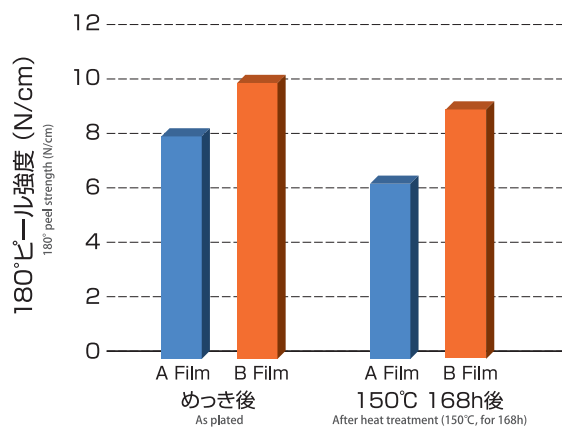
| | カタリスト中 パラジウム濃度 Palladium concentration in catalyst | パラジウム 吸着量 Palladium adsorption amount |
|--|---|--|
| トップSAPINAプロセス (アルカリイオンタイプ) TOP SAPINA PROCESS (Alkaline ion type) | 105mg/L | 17 μ g/dm ² |
| 従来プロセス (酸性コロイドタイプ) Conventional process (Acid colloid type) | 190mg/L | 30 μ g/dm ² |

金属濃度が低く、低コストなプロセス

Low metal concentration, cost-effective process

ピール強度の低下が小さい

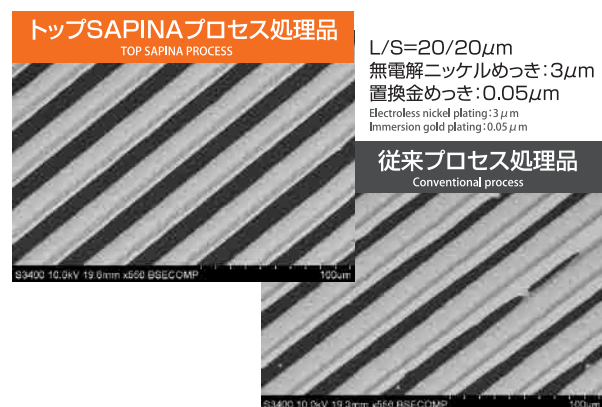
Maintain peel strength



ピール強度の比較 (銅膜厚 18 μ m)
Comparison of peel strength (Copper thickness 18 μ m)

優れたファインパターン性

Excellent in fine patterning performance



パラジウム吸着量が低く、ニッケル/金めっき時のパターン性に優れる

Great fine pattern ability of nickel/gold plating
Because of low palladium adsorption amount